

課題番号 : F-13-WS-0036  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名 (日本語) : ALD-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜の耐熱性検討  
Program Title (in English) : Heat resistance of ALD-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> films  
利用者名 (日本語) : 大長 央  
Username (in English) : Akira Daicho  
所属名 (日本語) : 早稲田大学 先進理工学科 ナノ理工学専攻  
Affiliation (in English) : School of Science & engineering, Waseda University.

1. 概要 (Summary) :

従来のダイヤモンド素子は、200℃が動作上限であった。これは、ダイヤモンドの表面が部分的にむき出しであることが原因であることが分かった。そこで、その対策を相談した。

相談の結果、ALD-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜を用いて表面を保護することとなった。しかし、保護膜自体にも耐熱性が必要となる。そこで、ALD-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜の耐熱性を検討することにした。

2. 実験 (Experimental) :

なし。

3. 結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

4. その他・特記事項 (Others) :

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) :

なし。

6. 関連特許 (Patent) :

なし。